



## 技术简讯

[ 1 / 3 ]

FA-CN-0417-A

### MELSEC系列CC-Link系统用终端电阻的外观变更通知(2023年9月生产的产品开始)

■出版年月

2023年9月

■相关机型

RJ61BT11、QJ61BT11N、LJ61BT11、L26CPU-BT、L26CPU-PBT、NZ2GF-CCB

感谢惠顾三菱电机可编程控制器。

此次，将变更CC-Link内置模块附带的终端电阻的外观，特此通知。

但是，与以往产品相比，产品的一般规格、性能规格、功能及外形尺寸不会因本次变更而发生变更。

## 1 对象机型

对象机型如下所示。

系列	品名	型号
MELSEC iQ-R	CC-Link系统主站/本地站模块	RJ61BT11
MELSEC-Q	CC-Link系统主站/本地站模块	QJ61BT11N
MELSEC-L	CC-Link系统主站/本地站模块	LJ61BT11
	CPU模块	L26CPU-BT L26CPU-PBT
—	CC-Link IE现场网络—CC-Link网桥模块	NZ2GF-CCB

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN  
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA 461-8670, JAPAN

## 2 变更内容

变更内容如下所示。

变更内容	变更前	变更后
压接端子部分将缩短3mm。 性能、功能与以往产品相比无变更。		

## 3 变更理由

为了确保稳定的部件采购和生产力。

## 4 变更时期

从2023年9月生产的产品开始依次替换。

此外，在产品流通阶段，变更前后的产品有可能同时存在，敬请谅解。

## 修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2023年9月	第一版

## 商标

The company names, system names, and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’ are not specified in this technical bulletin.